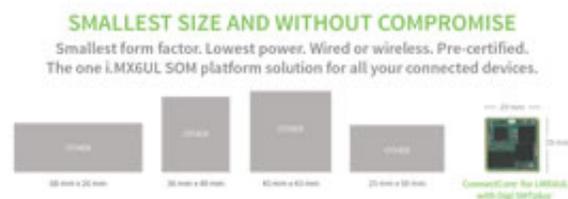


# Digi International präsentiert das ConnectCore 6UL Secure Wireless SoM für vernetzte Embedded-Geräte

*Kleinste Wireless SoM-Plattform auf dem Markt mit vollständig vorzertifiziertem Dualband-WLAN und Bluetooth Smart Ready Unterstützung Auf der Basis des neuen i.MX6UltraLite Prozessors von NMX*

**MINNETONKA, Minn., Mai. 19, 2016** - Digi International® (NASDAQ: DGII, [www.digi.com](http://www.digi.com)), ein weltweit führender Anbieter von Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) Verbindungslösungen und Dienstleistungen,

präsentierte **ConnectCore for i.MX 6UL**, die neue Embedded-Modul-Plattform, die ein System-on-Module (SoM) mit integriertem Dualband 802.11ac WLAN und Bluetooth 4.1 Connectivity bei oberflächenmontierbarem Low-Profile Formfaktor bietet und nur wenig größer als eine Briefmarke ist.



Auf dem neuen NXP i.MX 6UltraLite-Anwendungsprozessor aufbauend, ist das Modul als intelligente Embedded-Plattform mit geringen Abmessungen und niedrigem Stromverbrauch ausgelegt, die sehr kosteneffizient und zuverlässig in vernetzte Geräte ohne das herkömmliche Hardware oder Software-Designrisiko integriert werden kann und es den Geräteherstellern dadurch ermöglicht, sich einzig auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Der innovative und zum Patent angemeldete oberflächenmontierbare Digi SMTplus™ Formfaktor (29 mm x 29 mm x 3,75 mm) ermöglicht es den Geräteherstellern, das Produktdesign durch Verringerung der Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Fähigkeiten zu optimieren, ohne Kompromisse bei der Flexibilität des Designs machen zu müssen. Durch das Anbieten von zwei Integrationsoptionen (LGA Komplettsystem und vereinfachte Durchkontaktierungen mit metallisierten Kanten) mit einem gemeinsamen Formfaktor bietet Digi eine skalierbare Plattformlösung, die eine große Vielzahl an Anforderungen an Produkteigenschaften, Stückkostenziele und Designkompetenzniveaus berücksichtigt. Der oberflächenmontierbare

Formfaktor bietet zudem eine überaus verlässliche Montage für Anwendungen mit hoher Stoßfestigkeit und kompakten, flachen Geräten und beseitigt die Notwendigkeit kostenintensiver Board-to-Board-Verbindungen.

Digis komplettes Linux Board Support-Paket (BSP) + Softwareunterstützung besteht aus einer integrierten und geprüften regelmäßigen Softwarewartung auf der Grundlage aktueller und stabiler Community Releases. Im Rahmen der Linux-Software-Unterstützung bietet das neue Digi TrustFence™ Device Security Framework die entscheidenden Eigenschaften, die für den Schutz der heutigen vernetzten Geräte und Anwendungen erforderlich sind - eine starke Gerätesicherheit und damit Sicherheit für die Gerätehersteller und ihre Kunden gleichermaßen. Digi TrustFence implementiert Funktionen, die für die Gerätesicherheit relevant sind. Dazu gehören z.B. sichere Verbindungen, ein authentizierter Systemstart, verschlüsselte Datenspeicherung, Ports mit kontrolliertem Zugriff, sichere Software-Updates und nahtlose Integration des dedizierten On-Module-Secure-Elementes (SE).

„Das ConnectCore 6UL stärkt die führende Stellung von Digi im Bereich der Embedded- und Wireless-Technologie dadurch, dass es eine Entwicklungsplattform für vernetzte Produkte mit kompletter Hardware und Softwareunterstützung bereitstellt, darunter auch eine starke Unterstützung der Sicherheit von Embedded-Geräten“, so Mike Rohrmoser, Leiter Produktmanagement, Embedded Systems bei Digi International. „Kunden können jetzt intelligente und sichere vernetzte Geräte in einem Bruchteil der Zeit und der Anstrengungen auf den Markt bringen, indem sie mit einem starken Partner zusammenarbeiten, während sie sich gleichzeitig auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, ohne dabei Kompromisse bei der Designflexibilität machen zu müssen.“

Die wichtigsten Eigenschaften der ConnectCore 6UL SOM Plattform:

- NXP i.MX 6UltraLite Anwendungsprozessor
  - Cortex-A7 mit bis zu 696 MHz
- NXP PF3000 Energiemanagement-IC (PMIC)
- Unabhängiges On-Module Cortex-M0+ Microcontroller Assist™-Subsystem
  - Ultra-low Powermodi, Watchdog, Interface-Erweiterung, individuelle Anwendungen
- Bis zu 2 GB verlässlicher SLC NAND-Flash und bis zu 1 GB DDR3
- Vorzertifizierte 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth 4.1 (Smart Ready)-Option
- Integrierte Dual Ethernet-Konnektivität (10/100)
- Dediziertes intelligentes Secure Element (NXP)
- Digi SMT plus Formfaktor (zum Patent angemeldet) - ultrakompakt, kosteneffizient und zuverlässig

- Bestückung mit 245-Pad LGA oder 76-Pad Durchkontaktierungen mit metallisierten Kanten
- Linux BSP und Software Support, mit vollständigem Quellcode
  - Einschließlich Digi TrustFence Embedded Device Security Framework
- Branchenüblicher Temperaturbereich
- Langfristige Verfügbarkeit der Digi-Produkte
- Starke Garantie von 5 Jahren auf die Hardware von Digi

„NXP bietet ein konkurrenzloses Produktportfolio, das das unglaubliche Wachstum intelligenter, verbundener Lösungen unterstützt. Die ConnectCore 6UL SoM-Plattform zeigt, wie langjährige Partner wie Digi branchenführende Produkte liefern, die auf i.MX, Kinetis®, Security- und NFC-Produkten aufbauen. NXP-Produkte sind die zuverlässige Grundlage des Internet-of-Things (IoT), die unsere Kunden jetzt und in der Zukunft vertrauensvoll nutzen“, sagte Ron Martino, Vice President, i.MX Applications Processor and Advanced Technology Adoption, NXP Semiconductors.

Die Digi ConnectCore 6UL Entwicklungskits werden in zwei Versionen erhältlich sein: Das ConnectCore 6UL Starter Kit\* erhältlich ab August 2016 für 124 USD und das ConnectCore 6UL Jumpstart Kit\* wird voraussichtlich ab September 2016 für 249 USD erhältlich sein. Die Kits werden bei autorisierten Digi-Vertriebshändlern erhältlich sein.

Digi bietet seinen Kunden zusätzliche „Go-to-Market“-Optionen an. Das Wireless Design Services Team von Digi leistet Hilfestellung bei Auswahl und Entwicklung von Antennen und bietet Unterstützung bei der Mobilfunkintegration und Zertifizierung ebenso an wie maßgeschneiderte Sonderanfertigungen.

Weitere Informationen zum ConnectCore 6UL erhalten Sie unter [www.digi.com/cc6ul](http://www.digi.com/cc6ul).

*\*Starter- und SBC-Boards sind produktionsfertig und werden getrennt zum Kauf angeboten. Beide Kits sind auch Referenzdesigns für Digi SMTplus LGA und die Modulintegration von Durchkontaktierungen mit metallisierten Kanten, ein vollständiges Source-File für das Layout ist verfügbar. Eingeschränkte Verfügbarkeit der Muster des ConnectCore UL6-Modul im 3. Quartal 2016, der Beginn der Serienfertigung ist zum Ende des vierten Quartals 2016 geplant.*

## **Über Digi International**

Digi International (NASDAQ: DGII) ist Ihr Experte für auftragsentscheidende M2M-Lösungen und bietet eines der branchenweit breitesten Angebote von drahtlosen Produkten, eine auf die Geräte

abgestimmte Cloud-Computing-Plattform sowie Entwicklungsservices, mit denen die Kunden ihre drahtlosen Geräte und Anwendungen schneller auf den Markt bringen können. Das gesamte Angebot von Lösungen von Digi ist so abgestimmt, dass jedes Gerät überall auf der Welt mit jeder Anwendung kommunizieren kann. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von Digi unter [www.digi.com](http://www.digi.com) oder telefonisch unter 877-912-3444 (USA) bzw. 952-912-3444 (international).

**Pressekontakt:**

Europa

Vibeke Ulmann

Catalyst Communications

Geschäftsstelle: +44 (0)1323 760 335

[vibeke.ulmann@catalystpr.com](mailto:vibeke.ulmann@catalystpr.com)

**Nordamerika**

Rick McLaughlin

LEWIS

Geschäftsstelle: +1 781-418-2402

[rick.mclaughlin@teamlewis.com](mailto:rick.mclaughlin@teamlewis.com)